

企業説明会:2023/4/22(六)台湾時間13:00-14:00

■ 公司简介/会社概要					
公司名稱/会社名	台灣三榮高科技股份有限公司		公司地址/本社	台北市南港區園區街3-2號10樓	
公司網址/公式ページ	https://www.sanei-hy.co.jp/		員工人數/社員数	全球/グローバル：480	台灣/台湾：3
成立時間/設立	總公司/本社： 1977年11月	台灣/台湾： 2021年1月	股票上市/一部上場	☐ 是 / はい	☒ 否 / いいえ
公司理念/企業理念 (300字以内)	高い技術力、豊かな人間性を持ち、潤いある生活と、企業との調和ある発展を目指して団結し、社会の発展に寄与すべく邁進する。 ①顧客ニーズを把握し、満足していただける技術とサービスを提供する。 ②時代の変化に対応し、顧客との共存共栄に責任ある立場で行動する。 ③全社員の団結により、困難を克服し挑戦を続ける。 ④働き甲斐のある職場と信頼される企業を築き、豊かな生活を目指す。 変化の激しい半導体業界の未来を見定め、グローバルな視点と独自技術のさらなる研鑽を通じて、デジタル・イノベーションのパートナー企業を目指す。				
給求職者的話/ 参加者へのメッセージ (300字以内)	台灣三榮高科技は、「独立系設計専門企業」として、国内外の各社メーカーさまから依頼を受け、完成した設計データを提供する『受託設計ビジネス』を展開する三榮ハイテックス株式会社の完全子会社として2021年1月29日に台湾に設立されました。□ 日本本社と台湾顧客を繋ぐ企業のエンジニアとして活躍したい方を求めています。□ 台湾で経験を積んだ後、日本本社への転籍も可能です。□ 未知数の会社ですので、是非この機会にエンジニアリング、マネージメントのスキルを向上すべく挑戦してみたい方の応募をお待ちしております。				
公司福利/待遇	☐ 健康診断 ☐ 社員旅行 ☐ 教育補助 ☐ 団体保険 ☐ 帰国手当 ☒ 食事手当 ☐ 通勤手当 ☐ 住宅手当 ☐ 役職手当 ☐ 皆勤手当 ☐ 独身寮 ☐ 家族手当 ☐ 引っ越し補助 ☐ 車両手当 ☐ 社用車提供 ☐ その他 ()				
■ 預計開放職缺/募集要項					
1					
職位/職種	半導体設計エンジニア				
工作内容/業務内容	・アナログ回路／レイアウト設計 ・ASICバックエンド／物理実装設計 ※日本語利用場面：日本人マネージャーへの報告連絡／日本語の設計資料作成／日本側エンジニアとのコミュニケーション				
應徵條件/応募資格	・日本語検定 2級相当もしくは、日常会話レベル以上 ・半導体設計2年以上の経験 ※資格は不問ですが、連絡・面接等は日本語で行います。				
薪資範圍/給与 *NT\$4萬以上才可寫面議	月給：40,000元 ～ (※程度に応じて調整)		工作地點/勤務地	南港本社 (南港IC内)	
2					
職位/職種	ソフトウェア開発エンジニア				
工作内容/業務内容	・組み込みシステム開発／検証 ※日本語利用場面：日本人マネージャーへの報告連絡／日本語の設計資料作成／日本側エンジニアとのコミュニケーション				
應徵條件/応募資格	・日本語検定 2級相当もしくは、日常会話レベル以上 ・半導体設計2年以上の経験 ※資格は不問ですが、連絡・面接等は日本語で行います。				
薪資範圍/給与 *月薪NT\$4萬以上才可寫面議	月給：40,000元 ～ (※程度に応じて調整)		工作地點/勤務地	南港本社 (南港IC内)	
3					
職位/職種	IoTシステム開発エンジニア				
工作内容/業務内容	・IoTアプリケーション開発 ※日本語利用場面：日本人マネージャーへの報告連絡／日本語の設計資料作成／日本側エンジニアとのコミュニケーション				
應徵條件/応募資格	・日本語検定 2級相当もしくは、日常会話レベル以上 ・半導体設計2年以上の経験 ※資格は不問ですが、連絡・面接等は日本語で行います。				
薪資範圍/給与 *月薪NT\$4萬以上才可寫面議	月給：40,000元 ～ (※程度に応じて調整)		工作地點/勤務地	南港本社 (南港IC内)	